

凝固速度の異なるAl-Si-Cu-Mg合金の時効特性

メタデータ	言語: jpn		
	出版者: 室蘭工業大学地域共同研究開発センター		
	公開日: 2019-03-14		
	キーワード (Ja):		
	キーワード (En):		
	作成者: 安藤, 哲也, 古川, 勇		
	メールアドレス:		
	所属:		
URL	http://hdl.handle.net/10258/00009773		

凝固速度の異なる Al-Si-Cu-Mg 合金の時効特性

安藤哲也*1,古川勇*2

1 緒言

Al-Si-Cu-Mg 合金は、機械的性質、被削性、鋳造性に バランスのよい材料であり、アルミダイカスト用とし て自動車部品などに広く使用されている.アルミダイ カストの場合、内部に空気などが入った場合、これが 熱処理によって膨張して内部欠陥の原因となる可能性 があるため、多くはダイカストのまま使用されている. しかしながら、高真空プロセス等のダイカスト技術の 進化により、ダイカスト品にも熱処理が適用できるよ うになり、熱負荷の高い部分の要求特性に対応するた め、熱処理を実施している.近年、環境問題の観点か ら社会的に CO₂削減が求められ、製造過程においても、 部材としての性能を維持しつつ CO₂を削減することが 要求されている.

Al-Si-Cu-Mg 合金鋳物における組織形成に及ぼす冷 却速度の影響については, Aguilera-Luna らの研究¹⁾が あるが,析出強化に影響を及ぼす Cu 等の形態や人工時 効処理の影響についての言及はされていない.本研究 では,異なる冷却速度により鋳造した Al-Si-Cu-Mg 合 金鋳物における,人工時効処理後の機械的性質調査な らびに組織観察をおこない,凝固速度と時効処理特性 との関係について調査した.

2 実験方法

2.1 調査材 Al-11.0 mass%Si-1.9 mass%Cu-0.2 mass%Mg 合金を,

*1:もの創造系領域先進マテリアル工学ユニット

*2:トヨタ自動車株式会社

重力鋳造法により直径 60 mm, 高さ 150 mm の円柱状 に鋳造し,冷却条件を制御することにより二種類の異 なる冷却速度の鋳塊を得た.注湯直前の溶湯温度は約 800 ℃であり,実測した冷却曲線から算出される二種 類の凝固速度はそれぞれ,16 K/s および 7.7 K/s であっ た.鋳型材質は,前者にはクロム銅を,後者には SKD61 を用い,ともに肉厚は 20 mm とした.

2.2 調査項目

冷却速度測定をおこなった近傍より試験片を採取し, ミクロ組織観察および時効処理後の機械的性質測定を おこなった.

ミクロ組織観察は、光学顕微鏡、電子プローブマイ クロアナライザー(Electron Probe Micro Analyzer, EPMA) ならびに透過型電子顕微鏡(Transmission Electron Microscope, TEM)により実施した. EPMA分析では、 晶出物を同定することを目的とし、機器分析センター の日本電子 JEOL JXA-8900Rを用い、面分析ならびに 定量分析をおこなった. TEM の試料は、ツインジェッ ト法により30%ナイタール液を用いて作製し、観察は 機器分析センターの日本電子 JEOL JEM-2100Fを用い、 加速電圧 200 kV でおこなった.

鋳造材の機械的性質は、ビッカース硬さ測定ならび に引張試験によりおこなった.ビッカース硬さ測定は、 Future-tech FV-300A 硬さ試験機を用い、荷重 4.9 kN としておこなった.引張試験は、島津製作所 AG-50kNE 引張試験機を用い、試験片の平行部寸法は、外径 6 mm、 長さ 40 mm とした.

時効処理後の機械的性質は、150 ℃に設定した電気 炉内に24時間保持することにより人工時効処理をお こなった後に、ビッカース硬さ測定により実施した. 溶体化処理をおこなう場合には、540 ℃に設定した電 気炉内へ30分保持後に水冷し、直ちに人工時効処理を おこなった.

3 実験結果および考察

3.1 光学顕微鏡組織および EPMA 分析

光学顕微鏡によるミクロ組織観察を Fig.1 に示す. Fig.1 に示されたとおり, 凝固速度が約2倍に増加する ことに伴い針状晶出物が減少し, 粒状晶出物は微細化, 減少した.その一方で,初晶α相比率が増大している ことが確認された.

EPMA 分析の結果を Fig. 2 に示す. 晶出物の多くに は Si が検出された一方, Cu を主体とする晶出物の存 在も確認され, 凝固速度が 7.7 K/s の場合には, Cu と 同一位置に Mg が検出された. Cu を含んだ粒状晶出物 は, Q-Al₅Mg₈Si₆Cu₂相あるいは θ -CuAl₂相であると報告 されている ²が, Mg が存在していた位置には Si が検 出されていないことから, S-CuMgAl₂ 相の存在が示唆 された. S相, Q相, θ 相にはいずれも, 固溶強化また は時効処理後の析出強化に大きく寄与する Cu や Mg が 含まれているため, 凝固速度の増大に伴って粒状晶出 物が減少したことにより, Cu や Mg が晶出することな く過飽和に固溶したことが期待される.

3.2 機械的性質

鋳造材の機械的性質を Table 2 に示す. Table 2 に示 されたとおり、凝固速度差に対するビッカース硬さの 差(約12%増加)に比較し、引張強さの差は約2倍と 大きくなった. Fig.1 にみられたように、凝固速度の増



Fig.1 調査材の光学顕微鏡組織写真.



Fig.2 調査材の EPMA 分析結果.

Table 2	鋳造材の機械的性質
---------	-----------

Solidification rate / K/s	Vickers hardness	Tensile strength / MPa
7.7	92.8	129
16	104	248

大に伴って針状晶出物が減少していたが、一般に針状 Si相は延性の低下を招くことが知られており、延性の 増大に伴う加工硬化量の増大が引張強さの増大につな がったものと考えられた.

溶体化処理をおこなった後に人工時効処理した材料 (T6 処理材)ならびに鋳造のまま人工時効処理をおこ なった材料(T5 処理材)の,時効処理後の硬さ測定結 果を Fig. 3 に示す. Fig. 3 に示されたように,凝固速度 が 7.7 K/s, 16 k/s のいずれの材料においても,溶体化 処理後に人工時効処理をおこなった T6 処理材の場合 には,ほぼ同等の硬さの上昇が認められた.一方,T5 処理材の場合には、凝固速度が 7.7 K/s の材料の硬さ上 昇は約 15 %であったが、16 K/s の材料では約 30 %の硬 さ増大が生じ、T6 処理の場合とほぼ同じ硬さが得られ た.

光学顕微鏡組織観察において,16 K/s 材は7.7 K/s 材 に比較し,晶出物量が減少し,初晶α相比率が増大し ていたことから,凝固速度の増大に伴い,合金元素の 晶出が抑制されたことで過飽和に固溶し,その後の人 工時効処理により析出が生じたことで硬さ上昇に寄与 したものと推測された.



Fig.3人工時効処理後のビッカース硬さ測定結果.

3.3 透過電子顕微鏡組織

上記推定メカニズムを検証するため,硬さ上昇の生 じた凝固速度 16 K/s 材の T5 処理材に関し,TEM を用 いた STEM-EDX マッピング像を Fig. 4 に示す.Fig. 4 に示されたとおり,Si や Mg は均一に分散しているの に対し,Cu は濃縮が生じていることが確認された.

この濃縮が確認された領域において,入射電子線方向を[001]方向とした場合の制限視野回折(SAD)像ならびに回折スポットの解析結果を Fig. 5 に示す. Fig. 5 に示されたとおり,アルミニウム母相の回折スポットとは別に,母相と特定の方位関係をもつ析出物の回折スポットが確認された. Fig. 4 の結果を考慮すると,人工時効処理をおこなうことにより,Cu系の化合物が析出したものと考えられた.しかしながら,析出物の同定には至っていない.

4 結言

凝固速度の異なるにより Al-Si-Cu-Mg 合金鋳物にお ける、人工時効処理後の機械的性質調査ならびに組織 観察をおこない、凝固速度と時効処理特性との関係に ついて調査し、以下の結果を得た.

(1) 凝固速度の増大に伴い,晶出物の生成量が減少した.

前記は,合金元素が過飽和に固溶していることを示 唆するものである.

- (2) 人工時効処理後の機械的性質調査の結果, 凝固速度 が16 K/s の場合には, 溶体化処理を省略した T5 材の 場合においても, T6 材と同等の硬さが得られた.
- (3) 硬さの増大がみられた T5 材の TEM 観察の結果, Cu 系化合物と推測される析出物の存在が確認され た. すなわち,硬さ上昇の原因は,その析出強化に よるものと考えられた.

文献

 Aguilera-Luna, I., Castro-Román, M. J., Escobedo-Bocardo, J. C., García-Pastor, F. A. and Herrera-Trejo, M., Materials Characterization, 95 (2014), p211-218.

(2) Zheng, Y., Xiao, W., Ge, S., Zhao, W., Hanada, S. and Chaoli,M., Journal of Alloys and Compounds, 649 (2015), p291-295.



Fig. 4 透過電子顕微鏡 STEM-EDX マッピング ((a)BF 像, (b)Si, (c)Cu, (d)Mg).



Fig. 5 透過電子顕微鏡制限視野回折像 (入射電子線方向 // [001]).